

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
 【部門区分】第7部門第2区分
 【発行日】令和7年7月8日(2025.7.8)

【公開番号】特開2023-99431(P2023-99431A)
 【公開日】令和5年7月13日(2023.7.13)
 【年通号数】公開公報(特許)2023-131
 【出願番号】特願2022-146988(P2022-146988)
 【国際特許分類】

H 0 1 G 4 / 3 0 (2 0 0 6 . 0 1)

10

【 F I 】

H 0 1 G 4 / 3 0 2 0 1 F
 H 0 1 G 4 / 3 0 2 0 1 G
 H 0 1 G 4 / 3 0 2 0 1 K
 H 0 1 G 4 / 3 0 5 1 2
 H 0 1 G 4 / 3 0 5 1 3
 H 0 1 G 4 / 3 0 5 1 6

【手続補正書】

【提出日】令和7年6月30日(2025.6.30)

20

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

誘電体層、及び前記誘電体層を挟んで交互に配置される第1及び第2内部電極を含み、第1方向に対向する第1及び第2面、前記第1及び第2面と連結され、第2方向に対向する第3及び第4面、前記第1から第4面と連結され、第3方向に対向する第5及び第6面を含む本体と、

30

前記第3面に配置される第1接続部、及び前記第1接続部から前記第1面の一部まで延びる第1バンド部を含む第1外部電極と、

前記第4面に配置される第2接続部、及び前記第2接続部から前記第1面の一部まで延びる第2バンド部を含む第2外部電極と、

前記第1接続部上に配置される第1絶縁層、及び前記第2接続部上に配置される第2絶縁層と、

前記第1バンド部上に配置される第1めっき層と、

前記第2バンド部上に配置される第2めっき層と、

前記第1接続部と前記第3面との間に配置される第1追加電極層と、

40

前記第2接続部と前記第4面との間に配置される第2追加電極層と、を含み、

前記第1及び第2絶縁層はガラスを含み、

前記第1及び第2外部電極は銅(Cu)を含み、

前記第1及び第2追加電極層はNi及びNi合金のうち1つ以上を含む、積層型電子部品。

【請求項2】

前記第1及び第2絶縁層に含まれるガラスはSiを含む、請求項1に記載の積層型電子部品。

【請求項3】

前記第1及び第2絶縁層に含まれるSiのモル分率は、20mol%以上65mol%

50

以下である、請求項 2 に記載の積層型電子部品。

【請求項 4】

前記第 1 面から、前記第 1 及び第 2 内部電極のうち前記第 1 面に最も近く配置された内部電極までの第 1 方向の平均サイズを H_1 、前記第 1 面の延長線から前記第 1 及び第 2 接続部上に配置されためっき層の端までの第 1 方向の平均サイズを H_2 としたときに、 $H_1 > H_2$ を満たす、請求項 1 に記載の積層型電子部品。

【請求項 5】

前記第 1 面から、前記第 1 及び第 2 内部電極のうち前記第 1 面に最も近く配置された内部電極までの第 1 方向の平均サイズを H_1 、前記第 1 面の延長線から前記第 1 及び第 2 接続部上に配置されためっき層の端までの第 1 方向の平均サイズを H_2 としたときに、 $H_1 < H_2$ を満たす、請求項 1 に記載の積層型電子部品。

10

【請求項 6】

前記本体の第 1 方向の平均サイズを T としたときに、 $H_2 < T / 2$ を満たす、請求項 5 に記載の積層型電子部品。

【請求項 7】

前記第 1 及び第 2 めっき層は、前記第 1 面の延長線以下に配置される、請求項 1 に記載の積層型電子部品。

【請求項 8】

前記本体の第 2 方向の平均サイズを L 、前記第 3 面の延長線から前記第 1 バンド部の端までの前記第 2 方向の平均サイズを B_1 、前記第 4 面の延長線から前記第 2 バンド部の端までの前記第 2 方向の平均サイズを B_2 としたときに、 $0.2 B_1 / L < 0.4$ 及び $0.2 B_2 / L < 0.4$ を満たす、請求項 1 に記載の積層型電子部品。

20

【請求項 9】

前記第 1 面上に配置され、前記第 1 バンド部と前記第 2 バンド部との間に配置される追加絶縁層をさらに含む、請求項 1 に記載の積層型電子部品。

【請求項 10】

前記誘電体層の平均厚さは $0.35 \mu\text{m}$ 以下である、請求項 1 に記載の積層型電子部品。

【請求項 11】

前記第 1 及び第 2 内部電極の平均厚さは $0.35 \mu\text{m}$ 以下である、請求項 1 に記載の積層型電子部品。

30

【請求項 12】

前記本体は、前記誘電体層を挟んで交互に配置される第 1 及び第 2 内部電極を含む容量形成部、及び前記容量形成部の第 1 方向の両端面の間に配置されるカバー部を含み、前記カバー部の第 1 方向の平均サイズは $1.5 \mu\text{m}$ 以下である、請求項 1 に記載の積層型電子部品。

【請求項 13】

前記第 1 及び第 2 めっき層の平均厚さは、前記第 1 及び第 2 絶縁層のうち前記第 1 及び第 2 接続部上に配置された領域の平均厚さより薄い、請求項 1 に記載の積層型電子部品。

40

【請求項 14】

前記第 1 めっき層は、前記第 1 絶縁層の前記第 1 面に近い端を覆うように配置され、前記第 2 めっき層は、前記第 2 絶縁層の前記第 1 面に近い端を覆うように配置される、請求項 1 に記載の積層型電子部品。

【請求項 15】

前記第 1 絶縁層は、前記第 1 めっき層の前記第 1 外部電極上に配置された端を覆うように配置され、前記第 2 絶縁層は、前記第 2 めっき層の前記第 2 外部電極上に配置された端を覆うように配置される、請求項 1 に記載の積層型電子部品。

【請求項 16】

前記第 1 外部電極は、前記第 1 接続部から前記第 5 及び第 6 面の一部まで延びる第 1 側

50

面バンド部を含み、

前記第 2 外部電極は、前記第 2 接続部から前記第 5 及び第 6 面の一部まで延びる第 2 側面バンド部を含み、

前記第 1 及び第 2 側面バンド部の第 2 方向のサイズは、前記第 1 面に近くなるほど大きくなる、請求項 1 に記載の積層型電子部品。

【請求項 17】

前記第 1 及び第 2 外部電極は、前記第 5 及び第 6 面から離隔して配置される、請求項 1 に記載の積層型電子部品。

【請求項 18】

前記第 1 及び第 2 外部電極は、前記第 2 面から離隔して配置される、請求項 1 に記載の積層型電子部品。

10

【請求項 19】

前記第 1 及び第 2 絶縁層は、前記第 2 面に延びて互いに連結される、請求項 1 に記載の積層型電子部品。

【請求項 20】

前記第 1 及び第 2 絶縁層は、前記第 5 面及び第 6 面に延びて互いに連結される、請求項 1 に記載の積層型電子部品。

【請求項 21】

前記第 1 及び第 2 絶縁層は、前記第 2 面、第 5 面及び第 6 面上には配置されない、請求項 1 に記載の積層型電子部品。

20

【請求項 22】

前記第 1 外部電極は、前記第 1 接続部から前記第 2 面の一部まで延びる第 3 バンド部を含み、

前記第 2 外部電極は、前記第 2 接続部から前記第 2 面の一部まで延びる第 4 バンド部を含む、請求項 1 に記載の積層型電子部品。

【請求項 23】

前記本体は、前記第 1 面と第 3 面を連結する第 1 - 3 コーナー、前記第 1 面と第 4 面を連結する第 1 - 4 コーナー、前記第 2 面と第 3 面を連結する第 2 - 3 コーナー、前記第 2 面と第 4 面を連結する第 2 - 4 コーナーを含み、

前記第 1 - 3 コーナー及び第 2 - 3 コーナーは、前記第 3 面に近くなるほど前記本体の第 1 方向の中央に収縮された形態を有し、前記第 1 - 4 コーナー及び第 2 - 4 コーナーは、前記第 4 面に近くなるほど前記本体の第 1 方向の中央に収縮された形態を有しており、

30

前記第 1 外部電極は、前記第 1 接続部において、前記第 1 - 3 コーナー及び第 2 - 3 コーナー上に延びて配置される第 1 コーナー部を含み、前記第 2 外部電極は、前記第 2 接続部から前記第 1 - 4 コーナー及び第 2 - 4 コーナー上に延びて配置される第 2 コーナー部を含む、請求項 1 に記載の積層型電子部品。

【請求項 24】

前記第 3 面の延長線から前記第 1 コーナー部の端までの前記第 2 方向の平均サイズを B 3、前記第 4 面の延長線から前記第 2 コーナー部の端までの前記第 2 方向の平均サイズを B 4、前記第 3 面と前記第 2 内部電極が離隔した領域の第 2 方向の平均サイズを G 1、前記第 4 面と前記第 1 内部電極が離隔した領域の第 2 方向の平均サイズを G 2 としたときに

40

、
B 3 G 1 及び B 4 G 2 を満たす、請求項 23 に記載の積層型電子部品。

【請求項 25】

前記第 1 外部電極は、前記第 3 面上に配置される第 1 連結電極、及び前記第 1 面上に配置され、前記第 1 連結電極と連結される第 1 バンド電極を含み、

前記第 2 外部電極は、前記第 4 面上に配置される第 2 連結電極、及び前記第 1 面上に配置され、前記第 2 連結電極と連結される第 2 バンド電極を含む、請求項 1 に記載の積層型電子部品。

【請求項 26】

50

前記第 1 及び第 2 連結電極は、前記第 5 及び第 6 面から離隔して配置される、請求項 2 5 に記載の積層型電子部品。

【請求項 2 7】

前記第 1 及び第 2 連結電極は、前記第 2 面から離隔して配置される、請求項 2 5 に記載の積層型電子部品。

【請求項 2 8】

前記第 1 外部電極は、前記第 2 面に配置され、前記第 1 連結電極と連結される第 3 バンド電極をさらに含み、

前記第 2 外部電極は、前記第 2 面に配置され、前記第 2 連結電極と連結される第 4 バンド電極をさらに含む、請求項 2 5 に記載の積層型電子部品。

10

【請求項 2 9】

前記第 1 連結電極及び前記第 2 連結電極は、前記内部電極に含まれた金属と同一の金属を含む、請求項 2 5 に記載の積層型電子部品。

【請求項 3 0】

前記第 1 バンド電極及び前記第 2 バンド電極は、導電性金属及びガラスを含む焼成電極である、請求項 2 5 に記載の積層型電子部品。

【請求項 3 1】

前記第 1 連結電極及び前記第 2 連結電極は、導電性金属及びガラスを含む焼成電極である、請求項 2 5 に記載の積層型電子部品。

【請求項 3 2】

前記第 1 バンド電極及び前記第 2 バンド電極はめっき層である、請求項 2 5 に記載の積層型電子部品。

20

【請求項 3 3】

前記第 1 連結電極及び前記第 2 連結電極はめっき層である、請求項 2 5 に記載の積層型電子部品。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 2 9 7

【補正方法】変更

【補正の内容】

30

【0 2 9 7】

また、本発明で用いられた用語は、一例を説明するために説明されたものであるだけで、本発明を限定しようとする意図ではない。このとき、単数の表現は文脈上明確に異なる意味でない限り、複数を含む。

本明細書によれば、以下の各項目に記載の構成もまた開示される。

(項目 1)

誘電体層、及び前記誘電体層を挟んで交互に配置される第 1 内部電極及び第 2 内部電極を含み、第 1 方向に対向する第 1 面及び第 2 面、前記第 1 面及び前記第 2 面と連結されて第 2 方向に対向する第 3 面及び第 4 面、前記第 1 面から前記第 4 面と連結されて第 3 方向に対向する第 5 面及び第 6 面を有する本体と、

40

前記第 3 面に配置される第 1 接続部、前記第 1 接続部から前記第 1 面の一部まで延びる第 1 バンド部、及び前記第 1 接続部から前記第 2 面の一部まで延びる第 3 バンド部を含む第 1 外部電極と、

前記第 4 面に配置される第 2 接続部、前記第 2 接続部から前記第 1 面の一部まで延びる第 2 バンド部、及び前記第 2 接続部から前記第 2 面の一部まで延びる第 4 バンド部を含む第 2 外部電極と、

前記第 1 接続部及び前記第 2 接続部上に配置され、前記第 2 面、前記第 3 バンド部及び前記第 4 バンド部を覆うように配置される絶縁層と、

前記第 1 バンド部上に配置される第 1 めっき層と、

前記第 2 バンド部上に配置される第 2 めっき層と、を含み、

50

前記第 1 接続部と前記第 3 面との間には第 1 追加電極層が配置され、前記第 2 接続部と前記第 4 面との間には第 2 追加電極層が配置されており、

前記第 1 外部電極及び前記第 2 外部電極は Cu を含み、前記第 1 追加電極層及び前記第 2 追加電極層は Ni 及び Ni 合金のうち 1 つ以上を含む、積層型電子部品。

(項目 2)

前記第 1 面から、前記第 1 内部電極及び前記第 2 内部電極のうち前記第 1 面に最も近く配置された内部電極までの前記第 1 方向の平均サイズを H 1、

前記第 1 面の延長線から前記第 1 接続部及び前記第 2 接続部上に配置されためっき層の端までの前記第 1 方向の平均サイズを H 2 としたときに、

$H 1 > H 2$ を満たす、項目 1 に記載の積層型電子部品。

10

(項目 3)

前記第 1 面から、前記第 1 内部電極及び前記第 2 内部電極のうち前記第 1 面に最も近く配置された内部電極までの前記第 1 方向の平均サイズを H 1、

前記第 1 面の延長線から前記第 1 接続部及び前記第 2 接続部上に配置されためっき層の端までの前記第 1 方向の平均サイズを H 2 としたときに、

$H 1 < H 2$ を満たす、項目 1 に記載の積層型電子部品。

(項目 4)

前記本体の前記第 1 方向の平均サイズを T としたときに、

$H 2 < T / 2$ を満たす、項目 3 に記載の積層型電子部品。

(項目 5)

前記第 1 めっき層及び前記第 2 めっき層は、前記第 1 面の延長線以下に配置される、項目 1 から 4 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

20

(項目 6)

前記本体の前記第 2 方向の平均サイズを L、

前記第 3 面の延長線から前記第 1 バンド部の端までの前記第 2 方向の平均サイズを B 1

、

前記第 4 面の延長線から前記第 2 バンド部の端までの前記第 2 方向の平均サイズを B 2 としたときに、

$0.2 \leq B 1 / L \leq 0.4$ 及び $0.2 \leq B 2 / L \leq 0.4$ を満たす、項目 1 から 4 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

30

(項目 7)

前記第 1 面上に配置され、前記第 1 バンド部と前記第 2 バンド部との間に配置される追加絶縁層をさらに含む、項目 1 から 4 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 8)

前記第 3 面の延長線から前記第 1 バンド部の端までの前記第 2 方向の平均サイズを B 1

、

前記第 4 面の延長線から前記第 2 バンド部の端までの前記第 2 方向の平均サイズを B 2

、

前記第 3 面の延長線から前記第 3 バンド部の端までの前記第 2 方向の平均サイズを B 3

、

前記第 4 面の延長線から前記第 4 バンド部の端までの前記第 2 方向の平均サイズを B 4 としたときに、

$B 3 < B 1$ 及び $B 4 < B 2$ を満たす、項目 1 から 4 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

40

(項目 9)

前記積層型電子部品の前記第 2 方向の最大サイズが 1.1 mm 以下であり、前記第 3 方向の最大サイズが 0.55 mm 以下である、項目 1 から 4 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 10)

前記誘電体層の平均厚さが 0.35 μ m 以下である、項目 1 から 4 のいずれか一項に記

50

載の積層型電子部品。

(項目 1 1)

前記第 1 内部電極及び前記第 2 内部電極の平均厚さが $0.35 \mu\text{m}$ 以下である、項目 1 から 4 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 1 2)

前記誘電体層を挟んで交互に配置される前記第 1 内部電極及び前記第 2 内部電極を含む容量形成部、及び前記容量形成部の前記第 1 方向の両端面上に配置されるカバー部を含み、

前記カバー部の前記第 1 方向の平均サイズが $15 \mu\text{m}$ 以下である、項目 1 から 4 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

10

(項目 1 3)

前記第 1 めっき層及び前記第 2 めっき層の平均厚さが、前記絶縁層の平均厚さより薄い、項目 1 から 4 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 1 4)

前記第 1 めっき層は、前記絶縁層の前記第 1 外部電極上に配置された端を覆うように配置され、

前記第 2 めっき層は、前記絶縁層の前記第 2 外部電極上に配置された端を覆うように配置される、項目 1 から 4 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 1 5)

前記絶縁層は、前記第 1 めっき層の前記第 1 外部電極上に配置された端を覆うように配置され、

20

前記絶縁層は、前記第 2 めっき層の前記第 2 外部電極上に配置された端を覆うように配置される、項目 1 から 4 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 1 6)

前記第 1 外部電極は、前記第 1 接続部から前記第 5 面及び前記第 6 面の一部まで延びる第 1 側面バンド部を含み、

前記第 2 外部電極は、前記第 2 接続部から前記第 5 面及び前記第 6 面の一部まで延びる第 2 側面バンド部を含み、

前記第 1 側面バンド部及び前記第 2 側面バンド部の前記第 2 方向のサイズは、前記第 1 面に近くなるほど大きくなる、項目 1 から 4 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

30

(項目 1 7)

前記第 1 外部電極は、前記第 1 接続部から前記第 5 面及び前記第 6 面の一部まで延びる第 1 側面バンド部を含み、

前記第 2 外部電極は、前記第 2 接続部から前記第 5 面及び前記第 6 面の一部まで延びる第 2 側面バンド部を含み、

前記絶縁層は、前記第 1 側面バンド部及び前記第 2 側面バンド部、前記第 5 面及び前記第 6 面の一部を覆うように配置される、項目 1 から 4 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 1 8)

前記第 1 外部電極は、前記第 1 接続部から前記第 5 面及び前記第 6 面の一部まで延びる第 1 側面バンド部を含み、

40

前記第 2 外部電極は、前記第 2 接続部から前記第 5 面及び前記第 6 面の一部まで延びる第 2 側面バンド部を含み、

前記絶縁層は、前記第 1 側面バンド部、前記第 2 側面バンド部、前記第 5 面及び前記第 6 面を全て覆うように配置される、項目 1 から 4 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 1 9)

前記第 3 面の延長線から前記第 3 バンド部の端までの前記第 2 方向の平均サイズを B_3 、

前記第 4 面の延長線から前記第 4 バンド部の端までの前記第 2 方向の平均サイズを B_4

50

、
前記第 3 面と前記第 2 内部電極が離隔した領域の前記第 2 方向の平均サイズを G 1、
前記第 4 面と前記第 1 内部電極が離隔した領域の前記第 2 方向の平均サイズを G 2 としたときに、

B 3 G 1 及び B 4 G 2 を満たす、項目 1 から 4 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 2 0)

前記第 3 面の延長線から前記第 1 バンド部の端までの前記第 2 方向の平均サイズを B 1

、
前記第 4 面の延長線から前記第 2 バンド部の端までの前記第 2 方向の平均サイズを B 2 10
としたときに、

B 1 G 1 及び B 2 G 2 を満たす、項目 1 9 に記載の積層型電子部品。

(項目 2 1)

前記本体は、前記第 1 面と前記第 3 面を連結する第 1 - 3 コーナーと、前記第 1 面と前記第 4 面を連結する第 1 - 4 コーナーと、前記第 2 面と前記第 3 面を連結する第 2 - 3 コーナーと、前記第 2 面と前記第 4 面を連結する第 2 - 4 コーナーと、を含み、

前記第 1 - 3 コーナー及び前記第 2 - 3 コーナーは、前記第 3 面に近くなるほど前記本体の前記第 1 方向の中央に収縮された形態を有し、前記第 1 - 4 コーナー及び前記第 2 - 4 コーナーは、前記第 4 面に近くなるほど前記本体の前記第 1 方向の中央に収縮された形態を有しており、

20

前記第 1 外部電極は、前記第 1 - 3 コーナー及び前記第 2 - 3 コーナー上に配置されるコーナー部を含み、前記第 2 外部電極は、前記第 1 - 4 コーナー及び前記第 2 - 4 コーナー上に配置されるコーナー部を含む、項目 1 から 4 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 2 2)

誘電体層、及び前記誘電体層を挟んで交互に配置される第 1 内部電極及び第 2 内部電極を含み、第 1 方向に対向する第 1 面及び第 2 面、前記第 1 面及び前記第 2 面と連結されて第 2 方向に対向する第 3 面及び第 4 面、前記第 1 面から前記第 4 面と連結されて第 3 方向に対向する第 5 面及び第 6 面を有する本体と、

前記第 3 面に配置される第 1 接続部、前記第 1 接続部から前記第 1 面の一部まで延びる第 1 バンド部、及び前記第 1 接続部から前記第 2 面の一部まで延びる第 3 バンド部を含む第 1 外部電極と、

30

前記第 4 面に配置される第 2 接続部、前記第 2 接続部から前記第 1 面の一部まで延びる第 2 バンド部、及び前記第 2 接続部から前記第 2 面の一部まで延びる第 4 バンド部を含む第 2 外部電極と、

前記第 1 接続部及び前記第 2 接続部上に配置され、前記第 2 面、前記第 3 バンド部及び前記第 4 バンド部を覆うように配置される絶縁層と、

前記第 1 バンド部上に配置される第 1 めっき層と、

前記第 2 バンド部上に配置される第 2 めっき層と、を含み、

前記第 1 外部電極及び前記第 2 外部電極は Ni 及び Ni 合金のうち 1 つ以上を含み、
前記第 1 面から、前記第 1 内部電極及び前記第 2 内部電極のうち前記第 1 面に最も近く配置された内部電極までの前記第 1 方向の平均サイズを H 1、前記第 1 面の延長線から前記第 1 接続部及び前記第 2 接続部上に配置されためっき層の端までの前記第 1 方向の平均サイズを H 2 としたときに、 $H 1 > H 2$ を満たす、積層型電子部品。

40

(項目 2 3)

前記本体の前記第 2 方向の平均サイズを L、

前記第 3 面の延長線から前記第 1 バンド部の端までの前記第 2 方向の平均サイズを B 1

、
前記第 4 面の延長線から前記第 2 バンド部の端までの前記第 2 方向の平均サイズを B 2
としたときに、

50

0.2 B1/L 0.4及び0.2 B2/L 0.4を満たす、項目22に記載の積層型電子部品。

(項目24)

前記第1面上に配置され、前記第1バンド部と前記第2バンド部との間に配置される追加絶縁層をさらに含む、項目22に記載の積層型電子部品。

(項目25)

前記第3面の延長線から前記第1バンド部の端までの前記第2方向の平均サイズをB1、
前記第4面の延長線から前記第2バンド部の端までの前記第2方向の平均サイズをB2、

10

前記第3面の延長線から前記第3バンド部の端までの前記第2方向の平均サイズをB3、
前記第4面の延長線から前記第4バンド部の端までの前記第2方向の平均サイズをB4

としたときに、
B3 < B1及びB4 < B2を満たす、項目22に記載の積層型電子部品。

(項目26)

前記積層型電子部品の前記第2方向の最大サイズが1.1mm以下であり、前記第3方向の最大サイズが0.55mm以下である、項目22に記載の積層型電子部品。

(項目27)

前記誘電体層の平均厚さが0.35µm以下である、項目22に記載の積層型電子部品。

20

(項目28)

前記第1内部電極及び前記第2内部電極の平均厚さが0.35µm以下である、項目22に記載の積層型電子部品。

(項目29)

前記誘電体層を挟んで交互に配置される前記第1内部電極及び前記第2内部電極を含む容量形成部、及び前記容量形成部の前記第1方向の両端面上に配置されるカバー部を含み、

前記カバー部の前記第1方向の平均サイズが15µm以下である、項目22に記載の積層型電子部品。

30

(項目30)

前記第1めっき層及び前記第2めっき層の平均厚さが、前記絶縁層の平均厚さより薄い、項目22に記載の積層型電子部品。

(項目31)

前記第1めっき層は、前記絶縁層の前記第1外部電極上に配置された端を覆うように配置され、

前記第2めっき層は、前記絶縁層の前記第2外部電極上に配置された端を覆うように配置される、項目22に記載の積層型電子部品。

(項目32)

前記絶縁層は、前記第1めっき層の前記第1外部電極上に配置された端を覆うように配置され、

40

前記絶縁層は、前記第2めっき層の前記第2外部電極上に配置された端を覆うように配置される、項目22に記載の積層型電子部品。

(項目33)

前記第1外部電極は、前記第1接続部から前記第5面及び前記第6面の一部まで延びる第1側面バンド部を含み、

前記第2外部電極は、前記第2接続部から前記第5面及び前記第6面の一部まで延びる第2側面バンド部を含み、

前記第1側面バンド部及び前記第2側面バンド部の前記第2方向のサイズは、前記第1面に近くなるほど大きくなる、項目22に記載の積層型電子部品。

50

(項目 3 4)

前記第 1 外部電極は、前記第 1 接続部から前記第 5 面及び前記第 6 面の一部まで延びる第 1 側面バンド部を含み、

前記第 2 外部電極は、前記第 2 接続部から前記第 5 面及び前記第 6 面の一部まで延びる第 2 側面バンド部を含み、

前記絶縁層は、前記第 1 側面バンド部及び前記第 2 側面バンド部、前記第 5 面及び前記第 6 面の一部を覆うように配置される、項目 2 2 に記載の積層型電子部品。

(項目 3 5)

前記第 1 外部電極は、前記第 1 接続部から前記第 5 面及び前記第 6 面の一部まで延びる第 1 側面バンド部を含み、

前記第 2 外部電極は、前記第 2 接続部から前記第 5 面及び前記第 6 面の一部まで延びる第 2 側面バンド部を含み、

前記絶縁層は、前記第 1、第 2 側面バンド部、第 5 面及び前記第 6 面を全て覆うように配置される、項目 2 2 に記載の積層型電子部品。

(項目 3 6)

前記第 3 面の延長線から前記第 3 バンド部の端までの前記第 2 方向の平均サイズを B 3

、前記第 4 面の延長線から前記第 4 バンド部の端までの前記第 2 方向の平均サイズを B 4

、前記第 3 面と前記第 2 内部電極が離隔した領域の第 2 方向の平均サイズを G 1、
前記第 4 面と前記第 1 内部電極が離隔した領域の第 2 方向の平均サイズを G 2 としたときに、

B 3 G 1 及び B 4 G 2 を満たす、項目 2 2 に記載の積層型電子部品。

(項目 3 7)

前記第 3 面の延長線から前記第 1 バンド部の端までの前記第 2 方向の平均サイズを B 1

、前記第 4 面の延長線から前記第 2 バンド部の端までの前記第 2 方向の平均サイズを B 2 としたときに、

B 1 G 1 及び B 2 G 2 を満たす、項目 3 6 に記載の積層型電子部品。

(項目 3 8)

前記本体は、前記第 1 面と前記第 3 面を連結する第 1 - 3 コーナーと、前記第 1 面と前記第 4 面を連結する第 1 - 4 コーナーと、前記第 2 面と前記第 3 面を連結する第 2 - 3 コーナーと、前記第 2 面と前記第 4 面を連結する第 2 - 4 コーナーと、を含み、

前記第 1 - 3 コーナー及び前記第 2 - 3 コーナーは、前記第 3 面に近くなるほど前記本体の前記第 1 方向の中央に収縮された形態を有し、前記第 1 - 4 コーナー及び前記第 2 - 4 コーナーは、前記第 4 面に近くなるほど前記本体の前記第 1 方向の中央に収縮された形態を有しており、

前記第 1 外部電極は、前記第 1 - 3 コーナー及び前記第 2 - 3 コーナー上に配置されるコーナー部を含み、前記第 2 外部電極は、前記第 1 - 4 コーナー及び前記第 2 - 4 コーナー上に配置されるコーナー部を含む、項目 2 2 から 3 7 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 3 9)

誘電体層、及び前記誘電体層を挟んで交互に配置される第 1 内部電極及び第 2 内部電極を含み、第 1 方向に対向する第 1 面及び第 2 面、前記第 1 面及び前記第 2 面と連結されて第 2 方向に対向する第 3 面及び第 4 面、前記第 1 面から前記第 4 面と連結されて第 3 方向に対向する第 5 面及び第 6 面を有する本体と、

前記第 3 面に配置される第 1 接続部、前記第 1 接続部から前記第 1 面の一部まで延びる第 1 バンド部、及び前記第 1 接続部から前記第 2 面の一部まで延びる第 3 バンド部を含む第 1 外部電極と、

前記第 4 面に配置される第 2 接続部、前記第 2 接続部から前記第 1 面の一部まで延びる

10

20

30

40

50

第 2 バンド部、及び前記第 2 接続部から前記第 2 面の一部まで延びる第 4 バンド部を含む第 2 外部電極と、

前記第 1 接続部及び前記第 2 接続部上に配置され、前記第 2 面、前記第 3 バンド部及び前記第 4 バンド部を覆うように配置される絶縁層と、

前記第 1 バンド部上に配置される第 1 めっき層と、

前記第 2 バンド部上に配置される第 2 めっき層と、を含み、

前記第 1 外部電極及び前記第 2 外部電極は Ni 及び Ni 合金のうち 1 つ以上を含み、

前記第 3 バンド部及び前記第 4 バンド部にはめっき層が配置されない、積層型電子部品

(項目 4 0)

10

前記第 1 接続部及び前記第 2 接続部は、前記第 5 面及び前記第 6 面から離隔して配置される、項目 3 9 に記載の積層型電子部品。

(項目 4 1)

前記第 1 面から、前記第 1 内部電極及び前記第 2 内部電極のうち前記第 1 面に最も近く配置された内部電極までの前記第 1 方向の平均サイズを H_1 、

前記第 1 面の延長線から前記第 1 接続部及び前記第 2 接続部上に配置されためっき層の端までの前記第 1 方向の平均サイズを H_2 としたときに、

$H_1 > H_2$ を満たす、項目 3 9 に記載の積層型電子部品。

(項目 4 2)

前記第 1 面から、前記第 1 内部電極及び前記第 2 内部電極のうち前記第 1 面に最も近く配置された内部電極までの前記第 1 方向の平均サイズを H_1 、

前記第 1 面の延長線から前記第 1 接続部及び前記第 2 接続部上に配置されためっき層の端までの前記第 1 方向の平均サイズを H_2 としたときに、

$H_1 < H_2$ を満たす、項目 3 9 に記載の積層型電子部品。

(項目 4 3)

前記本体の前記第 1 方向の平均サイズを T としたときに、

$H_2 < T / 2$ を満たす、項目 4 2 に記載の積層型電子部品。

(項目 4 4)

前記第 1 めっき層及び前記第 2 めっき層は、前記第 1 面の延長線以下に配置される、項目 3 9 から 4 3 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

30

(項目 4 5)

前記本体の第 2 方向の平均サイズを L 、

前記第 3 面の延長線から前記第 1 バンド部の端までの前記第 2 方向の平均サイズを B_1

、前記第 4 面の延長線から前記第 2 バンド部の端までの前記第 2 方向の平均サイズを B_2 としたときに、

$0.2 \leq B_1 / L \leq 0.4$ 及び $0.2 \leq B_2 / L \leq 0.4$ を満たす、項目 3 9 から 4 3 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 4 6)

前記第 1 面上に配置され、前記第 1 バンド部と前記第 2 バンド部との間に配置される追加絶縁層をさらに含む、項目 3 9 から 4 3 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

40

(項目 4 7)

前記第 3 面の延長線から前記第 1 バンド部の端までの前記第 2 方向の平均サイズを B_1

、前記第 4 面の延長線から前記第 2 バンド部の端までの前記第 2 方向の平均サイズを B_2

、前記第 3 面の延長線から前記第 3 バンド部の端までの前記第 2 方向の平均サイズを B_3

、前記第 4 面の延長線から前記第 4 バンド部の端までの前記第 2 方向の平均サイズを B_4 としたときに、

50

B 3 < B 1 及び B 4 < B 2 を満たす、項目 3 9 から 4 3 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 4 8)

前記積層型電子部品の前記第 2 方向の最大サイズが 1 . 1 m m 以下であり、前記第 3 方向の最大サイズが 0 . 5 5 m m 以下である、項目 3 9 から 4 3 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 4 9)

前記誘電体層の平均厚さが 0 . 3 5 μ m 以下である、項目 3 9 から 4 3 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 5 0)

前記第 1 内部電極及び前記第 2 内部電極の平均厚さが 0 . 3 5 μ m 以下である、項目 3 9 から 4 3 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 5 1)

前記誘電体層を挟んで交互に配置される前記第 1 内部電極及び前記第 2 内部電極を含む容量形成部、及び前記容量形成部の前記第 1 方向の両端面上に配置されるカバー部を含み、

前記カバー部の前記第 1 方向の平均サイズが 1 5 μ m 以下である、項目 3 9 から 4 3 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 5 2)

前記第 1 めっき層及び前記第 2 めっき層の平均厚さが、前記絶縁層の平均厚さより薄い、項目 3 9 から 4 3 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 5 3)

前記第 1 めっき層は、前記絶縁層の前記第 1 外部電極上に配置された端を覆うように配置され、

前記第 2 めっき層は、前記絶縁層の前記第 2 外部電極上に配置された端を覆うように配置される、項目 3 9 から 4 3 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 5 4)

前記絶縁層は、前記第 1 めっき層の前記第 1 外部電極上に配置された端を覆うように配置され、

前記絶縁層は、前記第 2 めっき層の前記第 2 外部電極上に配置された端を覆うように配置される、項目 3 9 から 4 3 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 5 5)

前記第 1 外部電極は、前記第 1 接続部から前記第 5 面及び前記第 6 面の一部まで延びる第 1 側面バンド部を含み、

前記第 2 外部電極は、前記第 2 接続部から前記第 5 面及び前記第 6 面の一部まで延びる第 2 側面バンド部を含み、

前記第 1 側面バンド部及び前記第 2 側面バンド部の前記第 2 方向のサイズは、前記第 1 面に近くなるほど大きくなる、項目 3 9 から 4 3 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 5 6)

前記第 1 外部電極は、前記第 1 接続部から前記第 5 面及び前記第 6 面の一部まで延びる第 1 側面バンド部を含み、

前記第 2 外部電極は、前記第 2 接続部から前記第 5 面及び前記第 6 面の一部まで延びる第 2 側面バンド部を含み、

前記絶縁層は、前記第 1 側面バンド部及び前記第 2 側面バンド部、前記第 5 面及び前記第 6 面の一部を覆うように配置される、項目 3 9 から 4 3 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 5 7)

前記第 1 外部電極は、前記第 1 接続部から前記第 5 面及び前記第 6 面の一部まで延びる第 1 側面バンド部を含み、

10

20

30

40

50

前記第 2 外部電極は、前記第 2 接続部から前記第 5 面及び前記第 6 面の一部まで延びる第 2 側面バンド部を含み、

前記絶縁層は、前記第 1 側面バンド部、前記第 2 側面バンド部、前記第 5 面及び前記第 6 面を全て覆うように配置される、項目 3 9 から 4 3 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 5 8)

前記第 3 面の延長線から前記第 3 バンド部の端までの前記第 2 方向の平均サイズを B 3

、前記第 4 面の延長線から前記第 4 バンド部の端までの前記第 2 方向の平均サイズを B 4

、前記第 3 面と前記第 2 内部電極が離隔した領域の前記第 2 方向の平均サイズを G 1、

前記第 4 面と前記第 1 内部電極が離隔した領域の前記第 2 方向の平均サイズを G 2 としたときに、

B 3 G 1 及び B 4 G 2 を満たす、項目 3 9 から 4 3 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 5 9)

前記第 3 面の延長線から前記第 1 バンド部の端までの前記第 2 方向の平均サイズを B 1

、前記第 4 面の延長線から前記第 2 バンド部の端までの前記第 2 方向の平均サイズを B 2 としたときに、

B 1 G 1 及び B 2 G 2 を満たす、項目 5 8 に記載の積層型電子部品。

(項目 6 0)

前記本体は、前記第 1 面と前記第 3 面を連結する第 1 - 3 コーナーと、前記第 1 面と前記第 4 面を連結する第 1 - 4 コーナーと、前記第 2 面と前記第 3 面を連結する第 2 - 3 コーナーと、前記第 2 面と前記第 4 面を連結する第 2 - 4 コーナーと、を含み、

前記第 1 - 3 コーナー及び前記第 2 - 3 コーナーは、前記第 3 面に近くなるほど前記本体の前記第 1 方向の中央に収縮された形態を有し、前記第 1 - 4 コーナー及び前記第 2 - 4 コーナーは、前記第 4 面に近くなるほど前記本体の前記第 1 方向の中央に収縮された形態を有しており、

前記第 1 外部電極は、前記第 1 - 3 コーナー及び前記第 2 - 3 コーナー上に配置されるコーナー部を含み、前記第 2 外部電極は、前記第 1 - 4 コーナー及び前記第 2 - 4 コーナー上に配置されるコーナー部を含む、項目 3 9 から 4 3 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 6 1)

誘電体層、及び前記誘電体層を挟んで交互に配置される第 1 内部電極及び第 2 内部電極を含み、第 1 方向に対向する第 1 面及び第 2 面、前記第 1 面及び前記第 2 面と連結されて第 2 方向に対向する第 3 面及び第 4 面、前記第 1 面から前記第 4 面と連結されて第 3 方向に対向する第 5 面及び第 6 面を有する本体と、

前記第 3 面に配置される第 1 接続部、前記第 1 接続部から前記第 1 面の一部まで延びる第 1 バンド部、及び前記第 1 接続部から前記第 2 面の一部まで延びる第 3 バンド部を含む第 1 外部電極と、

前記第 4 面に配置される第 2 接続部、前記第 2 接続部から前記第 1 面の一部まで延びる第 2 バンド部、及び前記第 2 接続部から前記第 2 面の一部まで延びる第 4 バンド部を含む第 2 外部電極と、

前記第 1 接続部及び前記第 2 接続部上に配置される絶縁層と、

前記第 1 バンド部上に配置される第 1 めっき層と、

前記第 2 バンド部上に配置される第 2 めっき層と、を含み、

前記第 1 外部電極及び前記第 2 外部電極は Ni 及び Ni 合金のうち 1 つ以上を含み、

前記絶縁層は、前記第 3 バンド部及び前記第 4 バンド部の端を覆うように前記第 2 面に延びて配置される、積層型電子部品。

10

20

30

40

50

(項目 6 2)

前記第 1 接続部及び前記第 2 接続部は、前記第 5 面及び前記第 6 面から離隔して配置される、項目 6 1 に記載の積層型電子部品。

(項目 6 3)

前記第 1 面から、前記第 1 内部電極及び前記第 2 内部電極のうち前記第 1 面に最も近く配置された内部電極までの前記第 1 方向の平均サイズを H_1 、

前記第 1 面の延長線から前記第 1 接続部及び前記第 2 接続部上に配置されためっき層の端までの前記第 1 方向の平均サイズを H_2 としたときに、

$H_1 > H_2$ を満たす、項目 6 1 に記載の積層型電子部品。

(項目 6 4)

前記第 1 面から、前記第 1 内部電極及び前記第 2 内部電極のうち前記第 1 面に最も近く配置された内部電極までの前記第 1 方向の平均サイズを H_1 、

前記第 1 面の延長線から前記第 1 接続部及び前記第 2 接続部上に配置されためっき層の端までの前記第 1 方向の平均サイズを H_2 としたときに、

$H_1 < H_2$ を満たす、項目 6 1 に記載の積層型電子部品。

(項目 6 5)

前記本体の前記第 1 方向の平均サイズを T としたときに、

$H_2 < T / 2$ を満たす、項目 6 4 に記載の積層型電子部品。

(項目 6 6)

前記第 1 めっき層及び前記第 2 めっき層は、前記第 1 面の延長線以下に配置される、項目 6 3 に記載の積層型電子部品。

(項目 6 7)

前記本体の前記第 2 方向の平均サイズを L 、

前記第 3 面の延長線から前記第 1 バンド部の端までの前記第 2 方向の平均サイズを B_1

、前記第 4 面の延長線から前記第 2 バンド部の端までの前記第 2 方向の平均サイズを B_2 としたときに、

$0.2 \leq B_1 / L \leq 0.4$ 及び $0.2 \leq B_2 / L \leq 0.4$ を満たす、項目 6 1 から 6 6 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 6 8)

前記第 1 面上に配置され、前記第 1 バンド部と前記第 2 バンド部との間に配置される追加絶縁層をさらに含む、項目 6 1 から 6 6 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 6 9)

前記第 3 面の延長線から前記第 1 バンド部の端までの前記第 2 方向の平均サイズを B_1

、前記第 4 面の延長線から前記第 2 バンド部の端までの前記第 2 方向の平均サイズを B_2

、前記第 3 面の延長線から前記第 3 バンド部の端までの前記第 2 方向の平均サイズを B_3

、前記第 4 面の延長線から前記第 4 バンド部の端までの前記第 2 方向の平均サイズを B_4 としたときに、

$B_3 < B_1$ 及び $B_4 < B_2$ を満たす、項目 6 1 から 6 6 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 7 0)

前記積層型電子部品の前記第 2 方向の最大サイズが 1.1 mm 以下であり、前記第 3 方向の最大サイズが 0.55 mm 以下である、項目 6 1 から 6 6 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 7 1)

前記誘電体層の平均厚さが $0.35 \mu\text{m}$ 以下である、項目 6 1 から 6 6 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

10

20

30

40

50

(項目 7 2)

前記第 1 内部電極及び前記第 2 内部電極の平均厚さが $0.35 \mu\text{m}$ 以下である、項目 6 1 から 6 6 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 7 3)

前記誘電体層を挟んで交互に配置される前記第 1 内部電極及び前記第 2 内部電極を含む容量形成部、及び前記容量形成部の前記第 1 方向の両端面上に配置されるカバー部を含み、

前記カバー部の前記第 1 方向の平均サイズが $15 \mu\text{m}$ 以下である、項目 6 1 から 6 6 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 7 4)

前記第 1 めっき及び前記第 2 めっき層の平均厚さが、前記絶縁層の平均厚さより薄い、項目 6 1 から 6 6 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 7 5)

前記第 1 めっき層は、前記絶縁層の前記第 1 外部電極上に配置された端を覆うように配置され、

前記第 2 めっき層は、前記絶縁層の前記第 2 外部電極上に配置された端を覆うように配置される、項目 6 1 から 6 6 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 7 6)

前記絶縁層は、前記第 1 めっき層の前記第 1 外部電極上に配置された端を覆うように配置され、

前記絶縁層は、前記第 2 めっき層の前記第 2 外部電極上に配置された端を覆うように配置される、項目 6 1 から 6 6 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 7 7)

前記第 1 外部電極は、前記第 1 接続部から前記第 5 面及び前記第 6 面の一部まで延びる第 1 側面バンド部を含み、

前記第 2 外部電極は、前記第 2 接続部から前記第 5 面及び前記第 6 面の一部まで延びる第 2 側面バンド部を含み、

前記第 1 側面バンド部及び前記第 2 側面バンド部の前記第 2 方向のサイズは、前記第 1 面に近くなるほど大きくなる、項目 6 1 から 6 6 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 7 8)

前記第 1 外部電極は、前記第 1 接続部から前記第 5 面及び前記第 6 面の一部まで延びる第 1 側面バンド部を含み、

前記第 2 外部電極は、前記第 2 接続部から前記第 5 面及び前記第 6 面の一部まで延びる第 2 側面バンド部を含み、

前記絶縁層は、前記第 1 側面バンド部及び前記第 2 側面バンド部、前記第 5 面及び前記第 6 面の一部を覆うように配置される、項目 6 1 から 6 6 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 7 9)

前記第 1 外部電極は、前記第 1 接続部から前記第 5 面及び前記第 6 面の一部まで延びる第 1 側面バンド部を含み、

前記第 2 外部電極は、前記第 2 接続部から前記第 5 面及び前記第 6 面の一部まで延びる第 2 側面バンド部を含み、

前記絶縁層は、前記第 1 側面バンド部、前記第 2 側面バンド部、前記第 5 面及び前記第 6 面を全て覆うように配置される、項目 6 1 から 6 6 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 8 0)

前記第 3 面の延長線から前記第 3 バンド部の端までの前記第 2 方向の平均サイズを B_3 、

前記第 4 面の延長線から前記第 4 バンド部の端までの前記第 2 方向の平均サイズを B_4

10

20

30

40

50

、
前記第 3 面と前記第 2 内部電極が離隔した領域の前記第 2 方向の平均サイズを G 1、
前記第 4 面と前記第 1 内部電極が離隔した領域の前記第 2 方向の平均サイズを G 2 としたときに、

B 3 G 1 及び B 4 G 2 を満たす、項目 6 1 から 6 6 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 8 1)

前記第 3 面の延長線から前記第 1 バンド部の端までの前記第 2 方向の平均サイズを B 1

、
前記第 4 面の延長線から前記第 2 バンド部の端までの前記第 2 方向の平均サイズを B 2 10
としたときに、

B 1 G 1 及び B 2 G 2 を満たす、項目 8 0 に記載の積層型電子部品。

(項目 8 2)

前記本体は、前記第 1 面と前記第 3 面を連結する第 1 - 3 コーナーと、前記第 1 面と前記第 4 面を連結する第 1 - 4 コーナーと、前記第 2 面と前記第 3 面を連結する第 2 - 3 コーナーと、前記第 2 面と前記第 4 面を連結する第 2 - 4 コーナーと、を含み、

前記第 1 - 3 コーナー及び前記第 2 - 3 コーナーは、前記第 3 面に近くなるほど前記本体の前記第 1 方向の中央に収縮された形態を有し、前記第 1 - 4 コーナー及び前記第 2 - 4 コーナーは、前記第 4 面に近くなるほど前記本体の前記第 1 方向の中央に収縮された形態を有しており、

20

前記第 1 外部電極は、前記第 1 - 3 コーナー及び前記第 2 - 3 コーナー上に配置されるコーナー部を含み、前記第 2 外部電極は、前記第 1 - 4 コーナー及び前記第 2 - 4 コーナー上に配置されるコーナー部を含む、項目 6 1 から 6 6 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 8 3)

誘電体層、及び前記誘電体層を挟んで交互に配置される第 1 内部電極及び第 2 内部電極を含み、第 1 方向に対向する第 1 面及び第 2 面、前記第 1 面及び前記第 2 面と連結されて第 2 方向に対向する第 3 面及び第 4 面、前記第 1 面から前記第 4 面と連結されて第 3 方向に対向する第 5 面及び第 6 面を有する本体と、

前記第 3 面に配置される第 1 接続部、前記第 1 接続部から前記第 1 面の一部まで延びる第 1 バンド部、及び前記第 1 接続部から前記第 2 面の一部まで延びる第 3 バンド部を含む第 1 外部電極と、

30

前記第 4 面に配置される第 2 接続部、前記第 2 接続部から前記第 1 面の一部まで延びる第 2 バンド部、及び前記第 2 接続部から前記第 2 面の一部まで延びる第 4 バンド部を含む第 2 外部電極と、

前記第 1 接続部及び前記第 2 接続部上に配置され、前記第 2 面、前記第 3 バンド部及び前記第 4 バンド部を覆うように配置される絶縁層と、

前記第 1 バンド部上に配置される第 1 めっき層と、

前記第 2 バンド部上に配置される第 2 めっき層と、を含み、

前記第 1 外部電極及び前記第 2 外部電極は Ni 及び Ni 合金のうち 1 つ以上を含み、
前記第 1 外部電極及び前記第 2 外部電極は前記第 2 面の延長線以下に配置される、積層型電子部品。

40

(項目 8 4)

前記第 1 接続部及び前記第 2 接続部は、前記第 5 面及び前記第 6 面から離隔して配置される、項目 8 3 に記載の積層型電子部品。

(項目 8 5)

前記第 1 面から、前記第 1 内部電極及び前記第 2 内部電極のうち前記第 1 面に最も近く配置された内部電極までの前記第 1 方向の平均サイズを H 1、

前記第 1 面の延長線から前記第 1 接続部及び前記第 2 接続部上に配置されためっき層の端までの前記第 1 方向の平均サイズを H 2 としたときに、

50

H 1 > H 2 を満たす、項目 8 3 に記載の積層型電子部品。

(項目 8 6)

前記第 1 面から、前記第 1 内部電極及び前記第 2 内部電極のうち前記第 1 面に最も近く配置された内部電極までの前記第 1 方向の平均サイズを H 1、

前記第 1 面の延長線から前記第 1 接続部及び前記第 2 接続部上に配置されためっき層の端までの前記第 1 方向の平均サイズを H 2 としたときに、

H 1 < H 2 を満たす、項目 8 3 に記載の積層型電子部品。

(項目 8 7)

前記本体の前記第 1 方向の平均サイズを T としたときに、

H 2 < T / 2 を満たす、項目 8 6 に記載の積層型電子部品。

10

(項目 8 8)

前記第 1 めっき層及び前記第 2 めっき層は、前記第 1 面の延長線以下に配置される、項目 8 3 から 8 7 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 8 9)

前記本体の第 2 方向の平均サイズを L、

前記第 3 面の延長線から前記第 1 バンド部の端までの前記第 2 方向の平均サイズを B 1

、前記第 4 面の延長線から前記第 2 バンド部の端までの前記第 2 方向の平均サイズを B 2 としたときに、

$0.2 \leq B 1 / L \leq 0.4$ 及び $0.2 \leq B 2 / L \leq 0.4$ を満たす、項目 8 3 から 8 7 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

20

(項目 9 0)

前記第 1 面上に配置され、前記第 1 バンド部と前記第 2 バンド部との間に配置される追加絶縁層をさらに含む、項目 8 3 から 8 7 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 9 1)

前記積層型電子部品の前記第 2 方向の最大サイズが 1.1 mm 以下であり、前記第 3 方向の最大サイズが 0.55 mm 以下である、項目 8 3 から 8 7 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 9 2)

前記誘電体層の平均厚さが $0.35 \mu\text{m}$ 以下である、項目 8 3 から 8 7 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

30

(項目 9 3)

前記第 1 内部電極及び前記第 2 内部電極の平均厚さが $0.35 \mu\text{m}$ 以下である、項目 8 3 から 8 7 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 9 4)

前記誘電体層を挟んで交互に配置される前記第 1 内部電極及び前記第 2 内部電極を含む容量形成部、及び前記容量形成部の前記第 1 方向の両端面上に配置されるカバー部を含み、

前記カバー部の前記第 1 方向の平均サイズが $15 \mu\text{m}$ 以下である、項目 8 3 から 8 7 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

40

(項目 9 5)

前記第 1 めっき層及び前記第 2 めっき層の平均厚さが、前記絶縁層の平均厚さより薄い、項目 8 3 から 8 7 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 9 6)

前記第 1 接続部及び前記第 2 接続部は、前記第 2 面から離隔して配置される、項目 8 3 から 8 7 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 9 7)

前記第 1 めっき層は、前記絶縁層の前記第 1 外部電極上に配置された端を覆うように配置され、

前記第 2 めっき層は、前記絶縁層の前記第 2 外部電極上に配置された端を覆うように配

50

置される、項目 83 から 87 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 98)

前記絶縁層は、前記第 1 めっき層の前記第 1 外部電極上に配置された端を覆うように配置され、

前記絶縁層は、前記第 2 めっき層の前記第 2 外部電極上に配置された端を覆うように配置される、項目 83 から 87 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 99)

前記絶縁層は、前記第 5 面及び前記第 6 面の一部を覆うように配置される、項目 83 から 87 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 100)

前記絶縁層は、前記第 5 面及び前記第 6 面の全部を覆うように配置される、項目 83 から 87 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 101)

前記本体は、前記第 1 面と前記第 3 面を連結する第 1 - 3 コーナーと、前記第 1 面と前記第 4 面を連結する第 1 - 4 コーナーと、前記第 2 面と前記第 3 面を連結する第 2 - 3 コーナーと、前記第 2 面と前記第 4 面を連結する第 2 - 4 コーナーと、を含み、

前記第 1 - 3 コーナー及び前記第 2 - 3 コーナーは、前記第 3 面に近くなるほど前記本体の前記第 1 方向の中央に収縮された形態を有し、前記第 1 - 4 コーナー及び前記第 2 - 4 コーナーは、前記第 4 面に近くなるほど前記本体の前記第 1 方向の中央に収縮された形態を有しており、

前記第 1 外部電極は、前記第 1 - 3 コーナー上に配置されるコーナー部及び前記第 1 接続部から前記第 2 - 3 コーナー上に延びて配置されるコーナー部を含み、前記第 2 外部電極は、前記第 1 - 4 コーナー上に配置されるコーナー部及び前記第 2 接続部から前記第 2 - 4 コーナー上に延びて配置されるコーナー部を含む、項目 83 から 87 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 102)

誘電体層、及び前記誘電体層を挟んで交互に配置される第 1 内部電極及び第 2 内部電極を含み、第 1 方向に対向する第 1 面及び第 2 面、前記第 1 及び前記第 2 面と連結されて第 2 方向に対向する第 3 面及び第 4 面、前記第 1 面から前記第 4 面と連結されて第 3 方向に対向する第 5 面及び第 6 面を有する本体と、

前記第 3 面に配置される第 1 接続部、前記第 1 接続部から前記第 1 面の一部まで延びる第 1 バンド部、及び前記第 1 接続部から前記第 2 面と第 3 面を連結するコーナーに延びて配置される第 1 コーナー部を含む第 1 外部電極と、

前記第 4 面に配置される第 2 接続部、前記第 2 接続部から前記第 1 面の一部まで延びる第 2 バンド部、及び前記第 2 接続部から第 2 面と第 4 面を連結するコーナーに延びて配置される第 2 コーナー部を含む第 2 外部電極と、

前記第 1 接続部及び前記第 2 接続部上に配置され、前記第 2 面、第 1 コーナー部及び前記第 2 コーナー部を覆うように配置される絶縁層と、

前記第 1 バンド部上に配置される第 1 めっき層と、

前記第 2 バンド部上に配置される第 2 めっき層と、を含み、

前記第 3 面の延長線から前記第 1 コーナー部の端までの前記第 2 方向の平均サイズを B3、前記第 4 面の延長線から前記第 2 コーナー部の端までの前記第 2 方向の平均サイズを B4、前記第 3 面と前記第 2 内部電極が離隔した領域の第 2 方向の平均サイズを G1、前記第 4 面と前記第 1 内部電極が離隔した領域の第 2 方向の平均サイズを G2 としたときに、

B3 G1 及び B4 G2 を満たし、

前記第 1 接続部と前記第 3 面との間には第 1 追加電極層が配置され、前記第 2 接続部と前記第 4 面との間には第 2 追加電極層が配置されており、

前記第 1 外部電極及び及び前記第 2 外部電極は Cu を含み、前記第 1 追加電極層及び前記第 2 追加電極層は Ni 及び Ni 合金のうち 1 つ以上を含む、積層型電子部品。

10

20

30

40

50

(項目 103)

前記第1面から、前記第1内部電極及び前記第2内部電極のうち前記第1面に最も近く配置された内部電極までの前記第1方向の平均サイズをH1、

前記第1面の延長線から前記第1接続部及び前記第2接続部上に配置されためっき層の端までの前記第1方向の平均サイズをH2としたときに、

H1 > H2を満たす、項目102に記載の積層型電子部品。

(項目 104)

前記第1面から、前記第1内部電極及び前記第2内部電極のうち前記第1面に最も近く配置された内部電極までの前記第1方向の平均サイズをH1、

前記第1面の延長線から前記第1接続部及び前記第2接続部上に配置されためっき層の端までの前記第1方向の平均サイズをH2としたときに、

H1 < H2を満たす、項目102に記載の積層型電子部品。

(項目 105)

前記本体の前記第1方向の平均サイズをTとしたときに、

H2 < T / 2を満たす、項目104に記載の積層型電子部品。

(項目 106)

前記第1めっき層及び前記第2めっき層は、前記第1面の延長線以下に配置される、項目102に記載の積層型電子部品。

(項目 107)

前記本体の前記第2方向の平均サイズをL、

前記第3面の延長線から前記第1バンド部の端までの前記第2方向の平均サイズをB1

、
前記第4面の延長線から前記第2バンド部の端までの前記第2方向の平均サイズをB2としたときに、

$0.2 \leq B1 / L \leq 0.4$ 及び $0.2 \leq B2 / L \leq 0.4$ を満たす、項目102から104のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 108)

前記第1面上に配置され、前記第1バンド部と前記第2バンド部との間に配置される追加絶縁層をさらに含む、項目102から104のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 109)

前記第3面の延長線から前記第1バンド部の端までの前記第2方向の平均サイズをB1

、
前記第4面の延長線から前記第2バンド部の端までの前記第2方向の平均サイズをB2としたときに、

$B3 < B1$ 及び $B4 < B2$ を満たす、項目102から104のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 110)

前記積層型電子部品の前記第2方向の最大サイズが1.1mm以下であり、前記第3方向の最大サイズが0.55mm以下である、項目102から104のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 111)

前記誘電体層の平均厚さが0.35µm以下である、項目102から104のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 112)

前記第1内部電極及び前記第2内部電極の平均厚さが0.35µm以下である、項目102から104のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 113)

前記誘電体層を挟んで交互に配置される前記第1内部電極及び前記第2内部電極を含む容量形成部、及び前記容量形成部の前記第1方向の両端面上に配置されるカバー部を含み

、

10

20

30

40

50

前記カバー部の前記第 1 方向の平均サイズが $15 \mu\text{m}$ 以下である、項目 102 から 104 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 114)

前記第 1 めっき層及び前記第 2 めっき層の平均厚さが、前記絶縁層の平均厚さより薄い、項目 102 から 104 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 115)

前記第 1 コーナー部及び前記第 2 コーナー部は、前記第 2 面の延長線以下に配置される、項目 102 から 104 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 116)

前記第 1 接続部及び前記第 2 接続部は、前記第 5 面及び前記第 6 面から離隔して配置される、項目 102 から 104 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 117)

前記第 1 コーナー部及び前記第 2 コーナー部は、前記第 2 面から離隔して配置される、項目 102 から 104 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 118)

前記第 1 めっき層は、前記絶縁層の前記第 1 外部電極上に配置された端を覆うように配置され、

前記第 2 めっき層は、前記絶縁層の前記第 2 外部電極上に配置された端を覆うように配置される、項目 102 から 104 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 119)

前記絶縁層は、前記第 1 めっき層の前記第 1 外部電極上に配置された端を覆うように配置され、

前記絶縁層は、前記第 2 めっき層の前記第 2 外部電極上に配置された端を覆うように配置される、項目 102 から 104 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 120)

前記絶縁層は、前記第 5 面及び前記第 6 面の一部を覆うように配置される、項目 102 から 104 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 121)

前記絶縁層は、前記第 5 面及び前記第 6 面の全部を覆うように配置される、項目 102 から 104 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 122)

前記第 3 面の延長線から前記第 1 バンド部の端までの前記第 2 方向の平均サイズを B_1 、

前記第 4 面の延長線から前記第 2 バンド部の端までの前記第 2 方向の平均サイズを B_2 としたときに、

$B_1 < G_1$ 及び $B_2 < G_2$ を満たす、項目 102 から 104 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 123)

誘電体層、及び前記誘電体層を挟んで交互に配置される第 1 内部電極及び第 2 内部電極を含み、第 1 方向に対向する第 1 面及び第 2 面、前記第 1 面及び前記第 2 面と連結されて第 2 方向に対向する第 3 面及び第 4 面、前記第 1 面から前記第 4 面と連結されて第 3 方向に対向する第 5 面及び第 6 面を有する本体と、

前記第 3 面に配置される第 1 連結電極、及び前記第 1 面に配置され、前記第 1 連結電極と連結される第 1 バンド電極を含む第 1 外部電極と、

前記第 4 面に配置される第 2 連結電極、及び前記第 1 面に配置され、前記第 2 連結電極と連結される第 2 バンド電極を含む第 2 外部電極と、

前記第 1 連結電極上に配置される第 1 絶縁層と、

前記第 2 連結電極上に配置される第 2 絶縁層と、

前記第 1 バンド電極上に配置される第 1 めっき層と、

前記第 2 バンド電極上に配置される第 2 めっき層と、を含み、

40

前記第 1 連結電極と前記第 3 面との間には第 1 追加電極層が配置され、前記第 2 連結電極と前記第 4 面との間には第 2 追加電極層が配置されており、

前記第 1 連結電極及び前記第 2 連結電極は Cu を含み、前記第 1 追加電極層及び前記第 2 追加電極層は Ni 及び Ni 合金のうち 1 つ以上を含む、積層型電子部品。

(項目 1 2 4)

前記第 1 面から、前記第 1 内部電極及び前記第 2 内部電極のうち前記第 1 面に最も近く配置された内部電極までの前記第 1 方向の平均サイズを H_1 、

前記第 1 面の延長線から前記第 1 連結電極及び前記第 2 連結電極上に配置された第 1 めっき層及び前記第 2 めっき層の端までの前記第 1 方向の平均サイズを H_2 としたときに、

$H_1 > H_2$ を満たす、項目 1 2 3 に記載の積層型電子部品。

10

(項目 1 2 5)

前記第 1 面から、前記第 1 及び前記第 2 内部電極のうち前記第 1 面に最も近く配置された内部電極までの前記第 1 方向の平均サイズを H_1 、

前記第 1 面の延長線から前記第 1 連結電極及び前記第 2 連結電極上に配置された第 1 めっき層及び前記第 2 めっき層の端までの前記第 1 方向の平均サイズを H_2 としたときに、

$H_1 < H_2$ を満たす、項目 1 2 3 に記載の積層型電子部品。

(項目 1 2 6)

前記本体の前記第 1 方向の平均サイズを T としたときに、

前記 H_2 及び前記 T は $H_2 < T / 2$ を満たす、項目 1 2 5 に記載の積層型電子部品。

(項目 1 2 7)

20

前記第 1 めっき層及び前記第 2 めっき層は、前記第 1 面の延長線以下に配置される、項目 1 2 3 から 1 2 6 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 1 2 8)

前記第 1 面上に配置され、前記第 1 バンド電極と前記第 2 バンド電極との間に配置される追加絶縁層をさらに含む、項目 1 2 3 から 1 2 6 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 1 2 9)

前記積層型電子部品の前記第 2 方向の最大サイズが 1.1 mm 以下であり、前記第 3 方向の最大サイズが 0.55 mm 以下である、項目 1 2 3 から 1 2 6 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

30

(項目 1 3 0)

前記誘電体層の平均厚さが $0.35 \mu\text{m}$ 以下である、項目 1 2 3 から 1 2 6 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 1 3 1)

前記第 1 内部電極及び前記第 2 内部電極の平均厚さが $0.35 \mu\text{m}$ 以下である、項目 1 2 3 から 1 2 6 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 1 3 2)

前記誘電体層を挟んで交互に配置される第 1 内部電極及び前記第 2 内部電極を含む容量形成部、及び前記容量形成部の前記第 1 方向の両端面上に配置されるカバー部を含み、

前記カバー部の前記第 1 方向の平均サイズが $15 \mu\text{m}$ 以下である、項目 1 2 3 から 1 2 6 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

40

(項目 1 3 3)

前記第 1 めっき層及び前記第 2 めっき層の平均厚さが、前記第 1 絶縁層及び前記第 2 絶縁層の平均厚さより薄い、項目 1 2 3 から 1 2 6 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 1 3 4)

前記第 1 連結電極及び前記第 2 連結電極は、前記第 5 面及び前記第 6 面から離隔して配置される、項目 1 2 3 から 1 2 6 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 1 3 5)

前記第 1 連結電極及び前記第 2 連結電極は、前記第 2 面から離隔して配置される、項目

50

1 2 3 から 1 2 6 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 1 3 6)

前記第 1 めっき層は、前記第 1 絶縁層の前記第 1 外部電極上に配置された端を覆うように配置され、

前記第 2 めっき層は、前記第 2 絶縁層の前記第 2 外部電極上に配置された端を覆うように配置される、項目 1 2 3 から 1 2 6 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 1 3 7)

前記第 1 絶縁層は、前記第 1 めっき層の前記第 1 外部電極上に配置された端を覆うように配置され、

前記第 2 絶縁層は、前記第 2 めっき層の前記第 2 外部電極上に配置された端を覆うように配置される、項目 1 2 3 から 1 2 6 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。 10

(項目 1 3 8)

前記第 1 絶縁層及び前記第 2 絶縁層は、前記第 5 面及び前記第 6 面に延びて互いに連結され、前記第 5 面及び前記第 6 面の一部を覆うように配置される、項目 1 2 3 から 1 2 6 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 1 3 9)

前記第 1 絶縁層及び前記第 2 絶縁層は、前記第 5 面及び前記第 6 面に延びて互いに連結され、前記第 5 面及び前記第 6 面の全部を覆うように配置される、項目 1 2 3 から 1 2 6 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 1 4 0)

前記第 1 絶縁層及び前記第 2 絶縁層は、前記第 2 面に延びて互いに連結される、項目 1 2 3 から 1 2 6 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。 20

(項目 1 4 1)

前記本体は、前記第 1 面と前記第 3 面を連結する第 1 - 3 コーナーと、前記第 1 面と前記第 4 面を連結する第 1 - 4 コーナーと、前記第 2 面と前記第 3 面を連結する第 2 - 3 コーナーと、前記第 2 面と前記第 4 面を連結する第 2 - 4 コーナーと、を含み、

前記第 1 - 3 コーナー及び前記第 2 - 3 コーナーは、前記第 3 面に近くなるほど前記本体の前記第 1 方向の中央に収縮された形態を有し、前記第 1 - 4 コーナー及び前記第 2 - 4 コーナーは、前記第 4 面に近くなるほど前記本体の前記第 1 方向の中央に収縮された形態を有しており、 30

前記第 1 連結電極は、前記第 1 - 3 コーナー及び前記第 2 - 3 コーナー上に延びて配置されるコーナー部を含み、前記第 2 連結電極は、前記第 1 - 4 コーナー及び前記第 2 - 4 コーナー上に延びて配置されるコーナー部を含む、項目 1 2 3 から 1 2 6 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 1 4 2)

前記第 1 外部電極は、前記第 2 面に配置されて前記第 1 連結電極と連結される第 3 バンド電極をさらに含み、

前記第 2 外部電極は、前記第 2 面に配置されて前記第 2 連結電極と連結される第 4 バンド電極をさらに含む、項目 1 2 3 から 1 2 6 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 1 4 3)

前記第 3 面の延長線から前記第 1 バンド電極の端までの距離を B 1、

前記第 4 面の延長線から前記第 2 バンド電極の端までの距離を B 2、

前記第 3 面の延長線から前記第 3 バンド電極の端までの距離を B 3、

前記第 4 面の延長線から前記第 4 バンド電極の端までの距離を B 4、

前記第 3 面と前記第 2 内部電極が離隔した領域の前記第 2 方向の平均サイズを G 1、

前記第 4 面と前記第 1 内部電極が離隔した領域の前記第 2 方向の平均サイズを G 2 としたときに、

B 1 G 1、B 3 G 1、B 2 G 2、及び B 4 G 2 を満たす、項目 1 4 2 に記載の積層型電子部品。

(項目 1 4 4)

50

前記第 3 面の延長線から前記第 1 バンド電極の端までの距離を B 1、
 前記第 4 面の延長線から前記第 2 バンド電極の端までの距離を B 2、
 前記第 3 面の延長線から前記第 3 バンド電極の端までの距離を B 3、
 前記第 4 面の延長線から前記第 4 バンド電極の端までの距離を B 4、
 前記第 3 面と前記第 2 内部電極が離隔した領域の前記第 2 方向の平均サイズを G 1、
 前記第 4 面と前記第 1 内部電極が離隔した領域の前記第 2 方向の平均サイズを G 2 としたときに、

B 1 G 1、B 3 G 1、B 2 G 2、及び B 4 G 2 を満たす、項目 1 4 2 に記載の積層型電子部品。

(項目 1 4 5)

10

前記第 1 バンド電極及び前記第 2 バンド電極は、前記内部電極に含まれた金属と同一の金属を含む、項目 1 2 3 から 1 2 6 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 1 4 6)

前記第 1 連結電極及び前記第 2 連結電極は、前記内部電極に含まれた金属と同一の金属を含む、項目 1 2 3 から 1 2 6 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 1 4 7)

前記第 1 バンド電極及び前記第 2 バンド電極は、導電性金属及びガラスを含む焼成電極である、項目 1 2 3 から 1 2 6 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 1 4 8)

前記第 1 連結電極及び前記第 2 連結電極は、導電性金属及びガラスを含む焼成電極である、項目 1 2 3 から 1 2 6 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

20

(項目 1 4 9)

前記第 1 バンド電極及び前記第 2 バンド電極がめっき層である、項目 1 2 3 から 1 2 6 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

(項目 1 5 0)

前記第 1 連結電極及び前記第 2 連結電極がめっき層である、項目 1 2 3 から 1 2 6 のいずれか一項に記載の積層型電子部品。

30

40

50